

产品技术数据表

Technical Data Sheet

3218

产品说明

3218 是环氧树脂（快速热固化）粘接胶，该产品专为在波峰焊和回流焊过程中的电子元器件粘接定位。3218 的粘度特性适合用于自动点胶和刮胶，具有优良的车载电气可靠性特性。特别适合于点胶速度大于 35000 点/小时的工艺。当印刷机印胶时，可以提供非常好的胶型。

典型用途

在回流焊之前将 SMT 元器件粘贴在印刷电路板上，尤其适合高速自动点胶的场合使用。

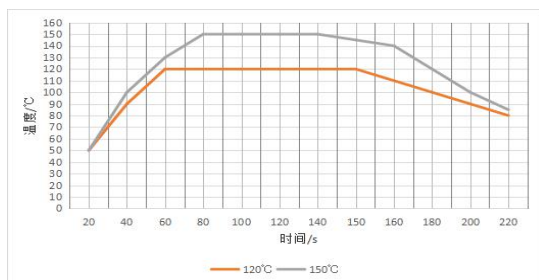
固化前材料性能

化学类型	环氧树脂
外观	红色
密度@25°C	1.18-1.26
卡松黏度@25°C, Pa.s:	椎板流变仪 M10 with PK1, 2° Cone:
卡森模型	0.4-30sec-1 1.50 (0.50-3.00)
粒子尺寸, μm	≤150
储存期限, 2-8°C, Day	180

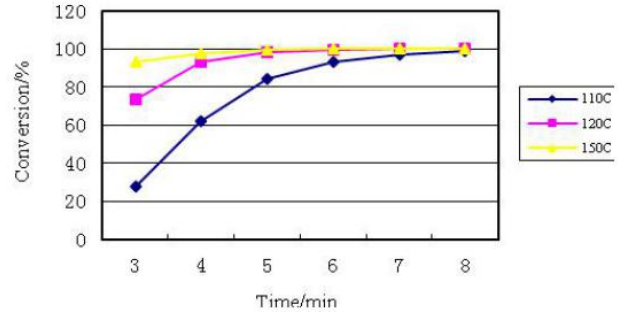
推荐的固化温度

适宜的固化条件是 150°C，90-120 秒，固化程度以及最终的强度取决于 PCB 板的类型以及元器件的数量，升温速率等条件。

下图为推荐温度固化曲线



下图为转化率与时间的曲线



固化后材料的典型性能 (150°C, 30mins)

物理性能

玻璃化转变温度, T _g , °C	110
抗剪强度, N/mm ²	13.5

粘接强度会取决于很多因素，比如元器件的类型，胶点的大小、类型、PCB 板上绿油的类型等。

电性能

介电常数和介质损耗 ASTM D150

	常数	损耗
1MHz	2.79	0.019

体积电阻率, ASTM D257, Ω·cm ³	1.3X10 ¹⁵
表面电阻率, ASTM D257, Ω	5.2X10 ¹⁶
电气强度, KV/mm	25

注意事项

本产品不宜在纯氧和或富氧环境中使用，不能用作氯气或其他强氧化性物质的密封材料。

有关本产品的安全注意事项，请查阅该产品的安全数据资料 (MSDS)。

使用指南

本产品应在冰箱冷藏保存，使用前回温 2-4 小时，操作时，对环境要求是 25°C 温度，相对湿度小于 70%。

储存条件

除标签上另有注明,本产品的理想储存条件是 2-8℃ 下将未开口的产品冷藏在干燥的地方。冷藏过的产品必须在恢复到室温之后方可使用。为避免污染原装胶黏剂,不得将任何用过的胶黏剂倒回原包装内。

说明

本文中所含的各种数据仅供参考,并确信是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果,我们恕不负责。决定把本产品用在用户的哪一种生产方法上,及采取哪一种措施来防止产品在储存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。